

臻鼎科技控股 (4958 TT)

2026年第一季營運成果

2026年5月12日



免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

1 2026年第一季營運成果

2 策略布局

3 營運規劃與執行

2026年第一季營運成果

第一季營運成果

單位: 新台幣佰萬元，除另予註明者外

	1Q26	1Q25	年變化 (%)
營業收入	40,728	40,082	+1.6%
營業毛利	8,812	5,885	+49.7%
營業毛利率	21.6%	14.7%	+6.9ppts
營業費用	6,308	4,829	+30.6%
營業利益	2,503	1,056	+137.1%
營業利益率	6.1%	2.6%	+3.5ppts
營業外收入及支出	(103)	401	-125.8%
匯兌損益	(930)	103	
本期淨利	2,047	1,025	+99.7%
淨利率	5.0%	2.6%	+2.4ppts
歸屬於母公司之淨利	1,426	632	+125.4%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	1.33	0.66	
折舊及攤銷	4,951	4,739	+4.5%
營運活動之現金流入	10,949	11,144	-1.7%
現金及約當現金 ⁽²⁾	82,480	85,879	-4.0%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	4.7%	2.7%	+2.0ppts

附註：(1) 2026年第一季加權平均流通在外股數為1,070,152仟股 (實際發行股本1,070,598仟股-庫藏股424仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

季度營運成果

營業收入

■ 2025 ■ 2026

單位：新台幣佰萬元

+1.6% YoY
40,082 40,728

38,203

47,366

56,870

1Q

2Q

3Q

4Q

毛利率 (%)

— 2025 — 2026

21.6%

14.7%

18.4%

22.0%

22.6%

淨利率 (%)

5.0%

2.6%

3.6%

7.6%

8.1%

1Q

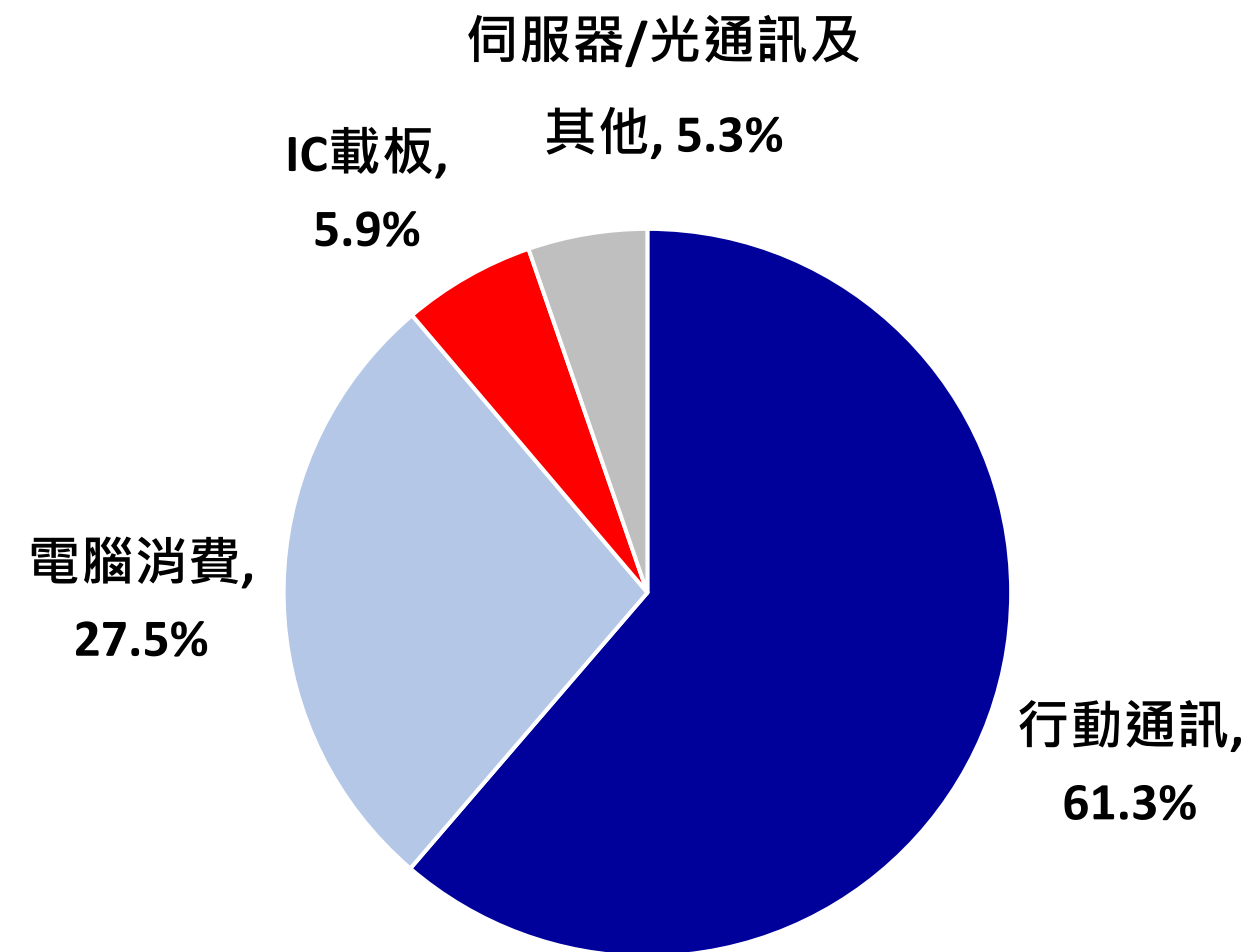
2Q

3Q

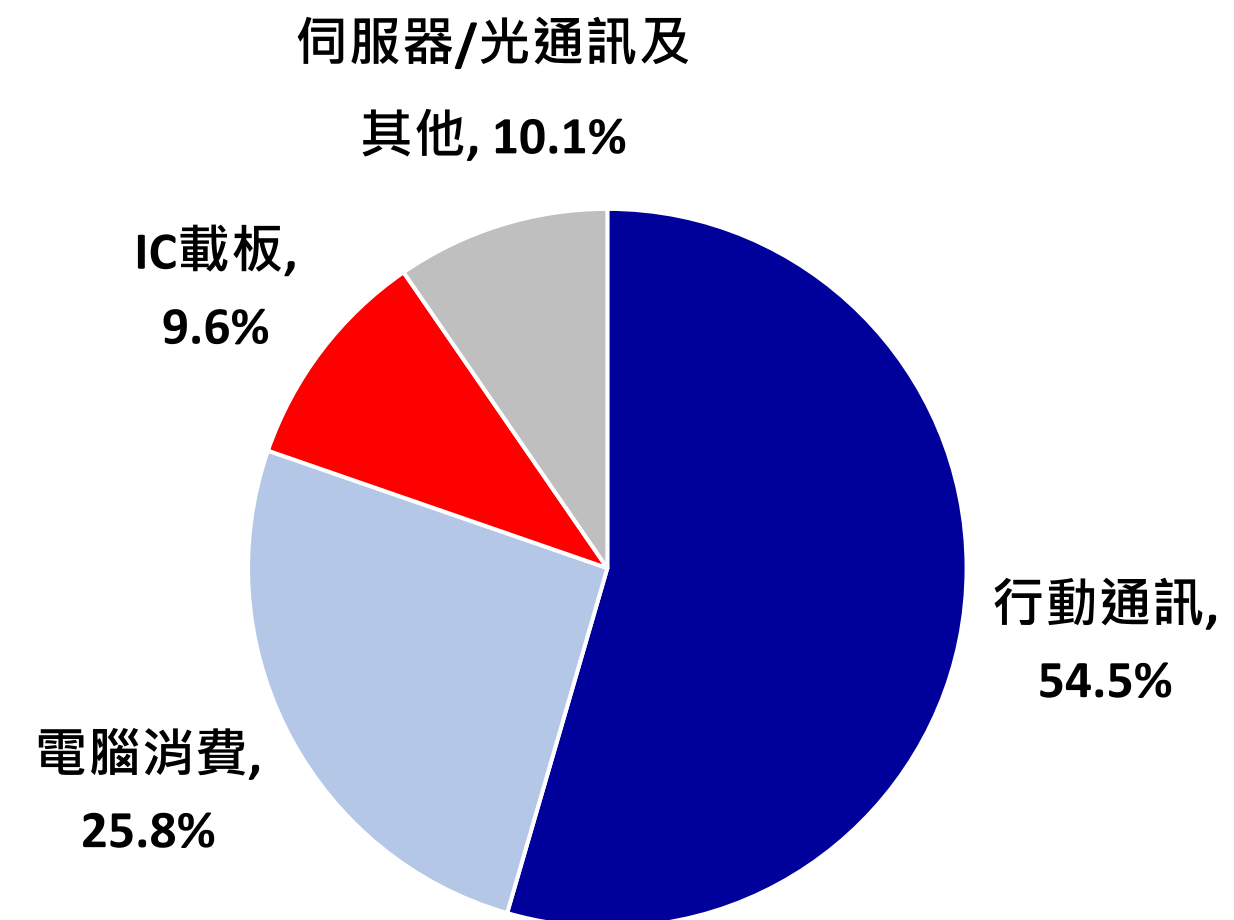
4Q

銷售分析-產品應用別

1Q25營收：新台幣401億



1Q26營收：新台幣407億



資產負債表及重要財務比率

	2026-3-31		2025-3-31		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	82,480	27.6%	85,879	32.3%	(3,399)	-4.7ppts
應收款項	22,078	7.4%	22,676	8.5%	(598)	-1.1ppts
存貨	23,795	8.0%	16,780	6.3%	7,015	+1.7ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	138,478	46.4%	115,397	43.4%	23,081	+3.0ppts
資產總額	298,403	100.0%	265,744	100.0%	32,659	
借款	64,648	21.7%	58,910	22.2%	5,738	+2.1ppts
應付款項	45,491	15.2%	40,893	15.4%	4,598	-0.2ppts
負債總額	123,678	41.4%	114,757	43.2%	8,921	-1.8ppts
股東權益總額	174,725	58.6%	150,987	56.8%	23,738	+1.8ppts

重要財務比率

平均收現日數(天)	60	60	-
平均銷貨日數(天)	66	49	17
流動比率(倍)	1.59	1.75	(0.16)
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.23	1.40	(0.17)

附註：(1) 2026年第一季加權平均流通在外股數為1,070,152仟股 (實際發行股本1,070,598仟股-庫藏股424仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 不動產、廠房 及設備 包含 投資性不動產。(4) 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額。

歷年營運成果

單位：新台幣佰萬元

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
營業收入	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398	171,664	182,522
營業毛利	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459	32,461	36,136
本期淨利	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432	13,096	10,605
母公司淨利	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189	9,180	6,791
折舊及攤銷	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323	17,749	18,552
每股盈餘 (元)	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.55	9.67	6.91
每股股利 (元)	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275	4.80	3.45
分派比率 (%)	51%	51%	43%	45%	51%	49%	40%	50%	50%	50%
現金及約當現金 *	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970	79,830	71,152
不動產、廠房及設備	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965	113,462	126,808
資本額	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470	9,567	10,706
資本支出	9,682	12,747	16,224	16,211	21,645	31,149	29,032	26,066	16,431	33,257
股東權益報酬率 (%)	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%	9.15%	6.57%
負債比率 (%)	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%	42.85%	39.04%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等

策略佈局

營運成果回顧暨未來展望

1

1Q26營運表現受惠高階AI應用：1Q26營收再創歷年同期新高，延續高階AI相關產品強勁成長動能。其中伺服器/光通訊營收年增翻倍，IC載板營收亦年增60%以上，兩者合計營收占比於第一季已接近20%，顯示公司營收結構正加速向高階AI應用傾斜。受惠產品組合優化，1Q26毛利率來到21.6%，創下歷年同期新高，營業利益率來到6.1%，較去年同期增加3.5個百分點。

2

高階AI應用持續發酵，2026年將成為新一輪高速成長周期的啟動年：自第二季起，隨客戶下一代AI平台陸續進入量產，伺服器/光通訊業務營收將逐季顯著成長，目標今年伺服器/光通訊營收成倍增長。IC載板方面，受惠AI算力需求持續強勁，公司已與多家客戶就高階AI相關產品展開緊密合作，隨著需求與訂單能見度同步提升，IC載板營收亦將呈逐季成長，目標今年IC載板營收成長70%+。

3

客戶需求驅動產能布局，加速建構全球AI PCB製造基地：鑒於公司已與多家關鍵客戶就中長期AI相關應用需求達成具體合作共識，公司將2026年資本支出由原先新台幣500億+進一步上調至800億+，以加速高階產能布局。相關投資將聚焦AI伺服器、光通訊、IC載板、與Edge AI等關鍵領域，並持續推進淮安及泰國等主要生產基地建設。其中，公司擴建淮安科技城，朝打造全球規模最大、技術最先進之單一PCB生產基地邁進，並逐步形成完整產業聚落。

4

推動禮鼎於港交所上市，強化IC載板長期成長動能：在IC載板業務方面，公司持續深化高階布局，旗下子公司禮鼎已啟動申請於香港聯合交易所上市之規劃。透過獨立上市引入國際資本市場資源，將加速其在AI伺服器及高速運算等高階應用領域之產能擴張與技術升級，進一步放大成長潛力。同時，公司將維持對禮鼎之控制權，確保整體策略與資源整合的一致性。整體而言，禮鼎獨立上市有助於更清晰呈現IC載板業務價值，並提升集團整體國際能見度與長期股東價值。

全球生產基地加速擴產，效益將於2026年起逐步顯現

擴產規劃

- 2025下半年至2029年將投入人民幣190億元，在淮安園區擴充高階PCB產能。
 - 規劃至2026年底，淮安園區iHDI與HLC產能將有6座新廠完成建設。
- 泰國一廠量產爬坡順利，預期2Q26達到滿產。
 - 泰國二廠廠房建置中，規劃2027年進入量產，產值預期達一廠2倍。
 - 三廠、五廠、機械鑽孔中心同步建置，滿足客戶不斷上升的高階AI產品需求。

- 分階段擴大高階ABF廠產能。
- 建置高階 PCB 產能。
- 軟板產線已量產並貢獻營收。

提升營運效益之策略

- 各廠區分階段導入智慧工廠與數位轉型，提升良率與營運效率，確保單位人均產值有效提升，進一步提升整體獲利率與競爭力。
- 已通過多家客戶認證及量產，尚有多家伺服器與光通訊全球領先客戶正積極進行認證中。泰國一廠以高階iHDI、HLC、及光通訊模組產品為主，量產後有助於優化產品組合，提升毛利率。
- 規劃生產超高階產品(30L~80L)。
 - 高雄AI園區之高階ABF載板與高階PCB產能陸續裝機試車，於1Q26進入打樣階段。



大陸廠區



泰國巴真府廠區



高雄AI園區

淮安科技城廠區規劃



泰國巴真府廠區規劃



致力推動EPS + ESG，國際ESG評比持續提升

► 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2025年S&P Global ESG評級進步至88分，並入選道瓊領先世界指數 (DJBIC World) 及道瓊領先新興市場指數 (DJBIC Emerging Markets)，亦於2022年至2025年連續4年入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)。

► 臺灣公司治理評鑑

2025年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度入選臺灣證券交易所公司治理100指數。

► Sustainalytics ESG 風險評級

最新Sustainalytics ESG風險評級為16.1，為低等風險等級。

► ISS ESG 評級

最新年度的ISS ESG評級為「C+」，獲得「優秀 (Prime)」等級。

► CDP 碳揭露專案

2025年在氣候變遷與水安全管理皆獲得「A」最高等級殊榮，其中氣候變遷為首度獲得A級，水安全則已連續兩年獲得A級。

► 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.5分（滿分為5分），成為台灣PCB企業第一名。

營運規劃與執行

各產品應用營運概況

伺服器/光通訊相關應用



- AI伺服器方面，GPU與ASIC客戶之 Intelligent HDI (iHDI) 與HLC產品將陸續轉量產，同時持續與客戶針對未來2-3個世代平台的產品進行開發。
- 光通訊方面，訂單以 1.6T高速率板為主，預期今年營收將年增數倍，同時客戶已開始預訂2027年產能。
目標2027年躍升為全球最大高階光通訊PCB供應商。

IC載板



- ABF載板受惠AI算力需求持續強勁，除既有客戶外，隨ABF新產能開出，將導入國際大型客戶，帶動營收加速成長。目前公司ABF載板最大尺寸達 158×158 mm，最高層數達28層，已達業界最前沿技術水準。
- BT載板平均稼動率維持高檔，1H26 將於秦皇島廠區進行去瓶頸擴產。

邊緣AI相關應用



AI手機/折疊機

AI眼鏡/VR/AR

- 2026年折疊機對 PCB 規格帶來明顯升級，無論軟板或硬板皆朝向更薄、更精密與更高製程難度發展。相較現行機型，折疊機新品單機板價值（dollar content）進一步提升，產品結構有利於毛利率表現。
- AI 眼鏡新機種在 PCB 設計與規格上均較既有產品升級，帶動整體產品結構優化，預期AI眼鏡營收在2026/2027年皆保持快速成長。

AI伺服器 PCB技術要求：臻鼎具備Tier 1技術能力

• GPU Servers

PCB	2022	2023	2024		2025		2026	2027
	NVIDIA HGX A100	NVIDIA HGX H200	NVIDIA HGX B200	NVIDIA NVL72 (GB200)	NVIDIA HGX B300	NVIDIA NVL72 (GB300)	NVIDIA NVL72 (VR200)	NVIDIA NVL576 (Rubin Ultra)
OAM	4+N+4 iHDI	5+N+5 iHDI	5+N+5 iHDI	5+N+5 iHDI (Compute Board)	5+N+5 iHDI	5+N+5 iHDI (Compute Board)	6+N+6 iHDI (Compute Board)	6+N+6 iHDI (Compute Board)
UBB	24-26L	26-28L	28-30L		28-30 L			
Mainboard	16L +	16-18L	16-20L		16-20 L			
Midplane							44 L RPCB	22L RPCB
Backplane								78/104L RPCB
Switch board	20L +	20-22L	22-24L	22L RPCB	22-24L	22L RPCB	24L iHDI	6+N+6 iHDI
Others				4+N+4 iHDI		4+N+4 iHDI RPCB-網路卡	4+N+4 iHDI RPCB-網路卡 MSAP-光模塊	4+N+4 iHDI

• ASIC Servers

PCB	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2026-2027
	Microsoft Maia200	Microsoft Maia300	Google TPU v7	Google TPU v8	Google TPU v9	Amazon Trainium 2+2.5	Amazon Trainium 3	Amazon Trainium 4	China ASIC Servers
OAM						3+N+3 iHDI	4+N+4 iHDI	iHDI	5+N+5 iHDI
UBB	26L+ RPCB (ASIC Board)	RPCB (ASIC Board)	28 L RPCB (TPU board)	30/34 L RPCB (TPU board)	30+L RPCB (TPU board)	24L RPCB	28/30L RPCB	36 L RPCB	26-28L RPCB
Others	CPU-RPCB 配版-RPCB	CPU-RPCB 配版-RPCB		配版-RPCB			CPU-RPCB Switch-RPCB 網路卡-RPCB	CPU-RPCB Switch-RPCB 網路卡-RPCB	Huawei 光模塊-MSAP NPU-iHDI

資料來源： Goldman Sachs Research(2026/1)

臻鼎將全面掌握HDI與高多層板(HLC)的黃金時代

Global AI server PCB market opportunity

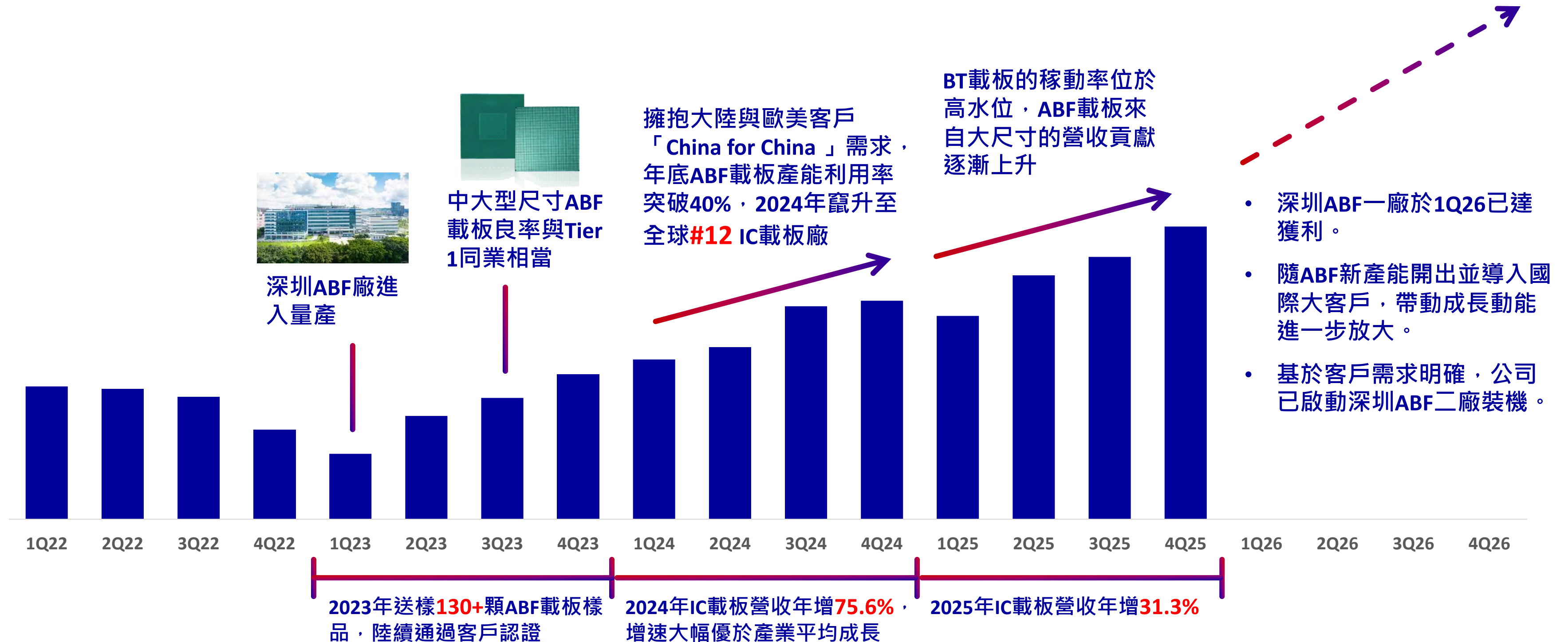
單位：百萬美元

應 用	2024	2025	2026F	2027F
GPU Server	1,407	2,242	4,493	15,887
OAM(加速板模組)	522	961	2,068	6,671
UBB(通用基板)	495	552	626	642
Mainboard(主板)	199	207	223	196
Midplane(中介板)			92	1,233
Backplane(背板)				1,941
Switch board(交換器板)	190	442	1,243	4,955
Others	2	80	241	248
ASIC Server	1,739	2,463	5,524	11,235
合計	3,146	4,706	10,017	27,122

產 品 技 術	2024	2025	2026F	2027F
RPCB	2,024	2,812	6,228	17,108
<20 layers	390	478	812	1,333
20-30 layers	1,379	1,972	4,034	9,023
30 layers+	255	361	1,382	6,752
HDI	1,122	1,894	3,789	10,014
4+N+4	18	80	241	248
5+N+5	1,079	1,799	3,447	6,329
6+N+6 or above	24	15	100	3,437
合計	3,146	4,706	10,017	27,122

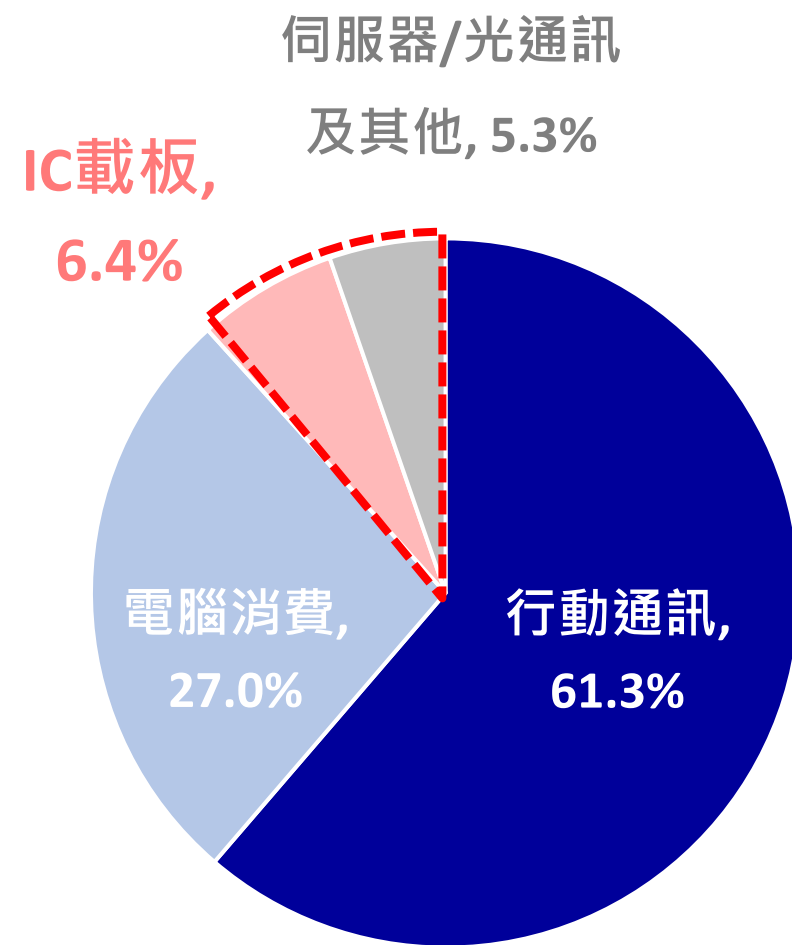
2026年IC載板營收目標成長70%+

臻鼎IC載板營收趨勢

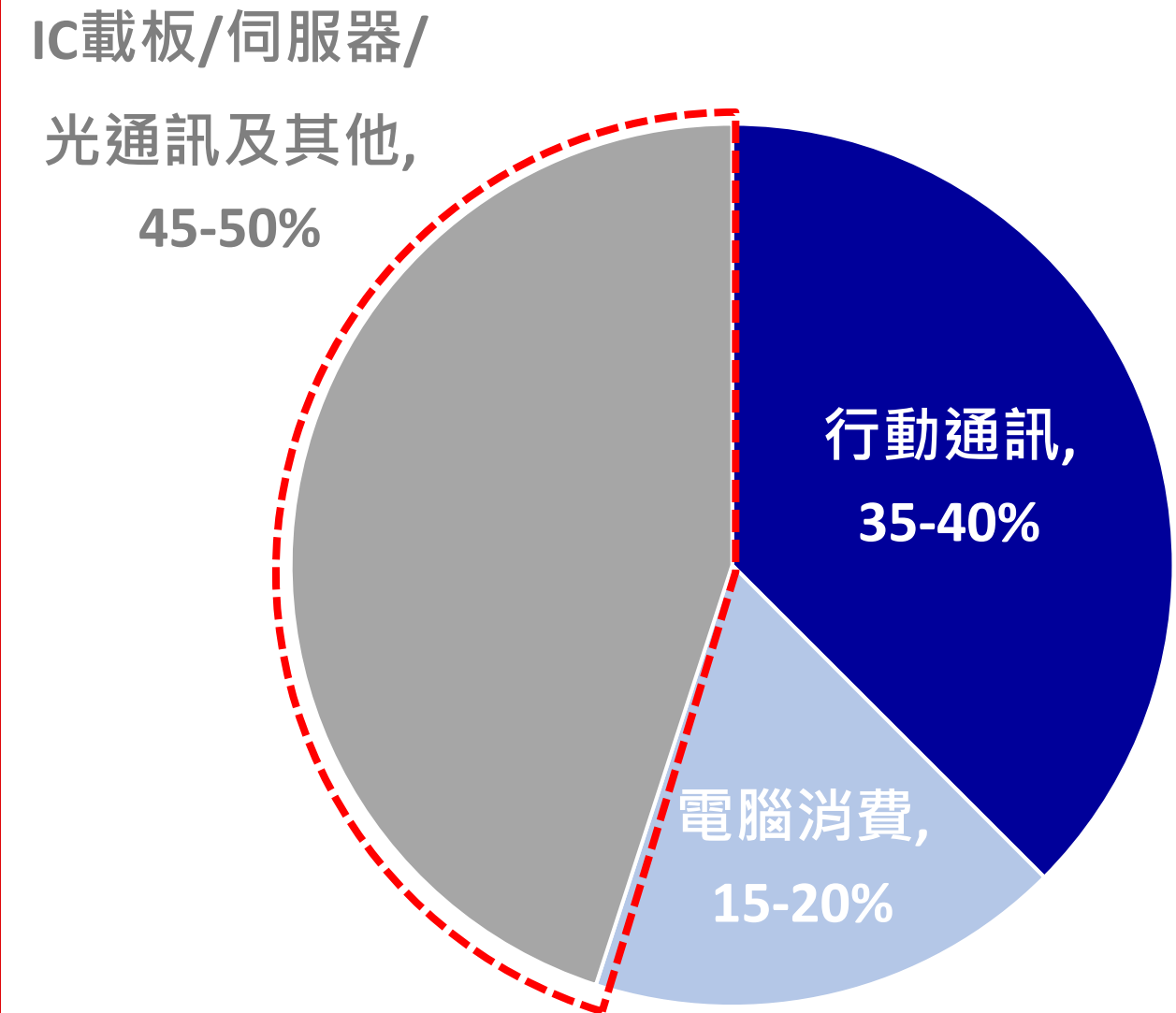


穩步推進伺服器/光通訊與IC載板佈局， 持續擴大營收貢獻

臻鼎：2025年產品應用營收佔比



臻鼎：2030年目標產品應用營收佔比





Thank You